

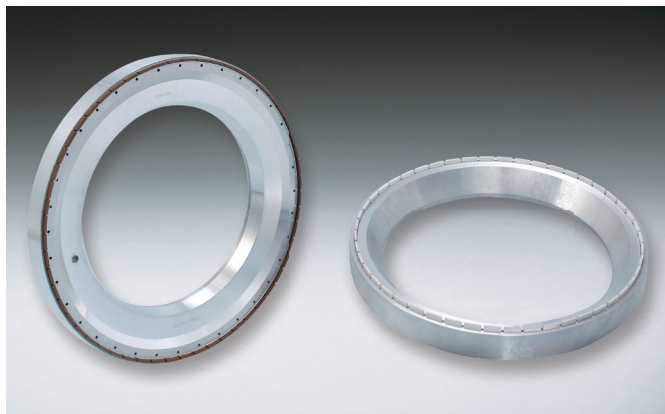
液晶・半導体関連

平面研削用ホイール

ビト レジン

用途

- ・シリコンウェーハの平坦化
- ・バックグラインディング

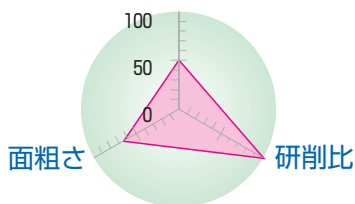


特長

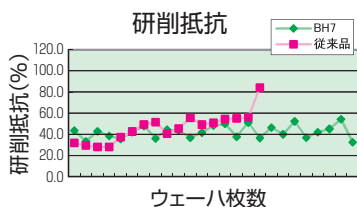
BH7

優れた自生作用を活かし、ノードレスでの連続研削が困難なエッチング面の研削においても、ノードレスでの連続研削が可能です。また、その自生作用をコントロール可能であるため、耐久性と研削抵抗とのバランスを最適にすることで高い研削比を得ることが可能です。

研削抵抗



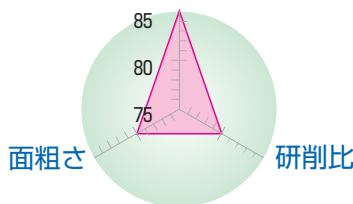
研削条件
 研削盤：東芝立形研削盤
 研削方式：インフィード研削
 試験ホイール：
 SD3000R24BH7
 被削材：シリコンウェーハ
 (エッチング面)



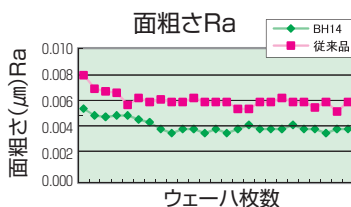
BH14

研削抵抗を下げる効果のある充填剤の使用と多孔質な組織を有しているため、非常に低負荷での研削が可能なボンドです。ダメージが少なく、良好な面品位を得たい場合には、BH14をお選び頂けます。

研削抵抗



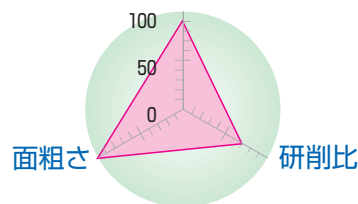
研削条件
 研削盤：東芝立形研削盤
 研削方式：インフィード研削
 試験ホイール：
 SD3000M48BH14
 被削材：シリコンウェーハ
 (#400 粗加工面)



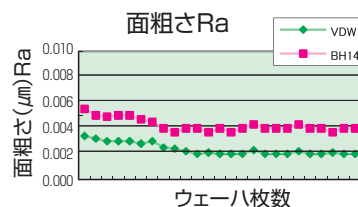
VDW

微粒なダイヤモンドと粒の均一分散を実現することにより、ビトリファイドボンドの欠点であったスクラッチ問題を解消したビトリファイド細目ホイールです。ビトリファイドボンドの強固なと粒保持力を利用して、レジノイドボンドでは使用限界であった平均粒径 1 μm 以下のダイヤモンドと粒を使用することにより、鏡面に近い面粗さを得ることが可能です。また多孔質ホイールであるため、研削抵抗の上昇も抑制可能です。

研削抵抗



研削条件
 研削盤：東芝立形研削盤
 研削方式：インフィード研削
 試験ホイール：SD8000VDW
 被削材：シリコンウェーハ
 (#400 粗加工面)



2-1

Super Abrasive

2-2

Bonded Abrasive

2-3

Dresser

2-4

Coated Abrasive

2-5

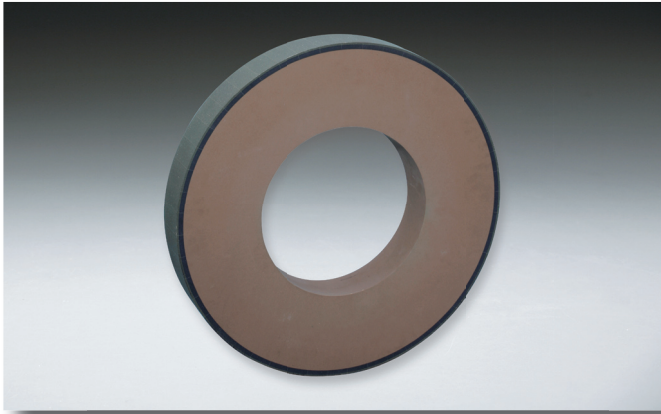
Coolant

2-6

Back Up

液晶・半導体関連

ファインセラミックス / シリコン / CFRP 研削用ホイール ビット



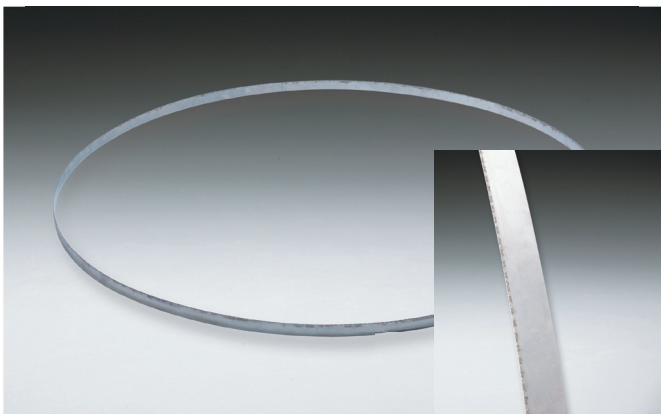
用途

- ・ファインセラミックス
- ・シリコン
- ・CFRP
- ・複合材料（セラミックス & 鋼）
- ・石英ガラス

高精度化、加工能率の向上、ドレスインターバルの向上が可能です。

液晶・半導体関連

電着ダイヤモンドバンドソー 電着



用途

- ・サファイア、炭化ケイ素、石英、シリコン等の高脆性材料や多結晶シリコンとセラミックスの複合体の切断加工に使われます。
- ・高強度基板と析出メッキの最適な組み合わせにより、高精度な切断が可能です。

Grinding
Application
Navigator

2-1

Super
Abrasive

2-2

Bonded
Abrasive

2-3

Dresser

2-4

Coated
Abrasive

2-5

Coolant

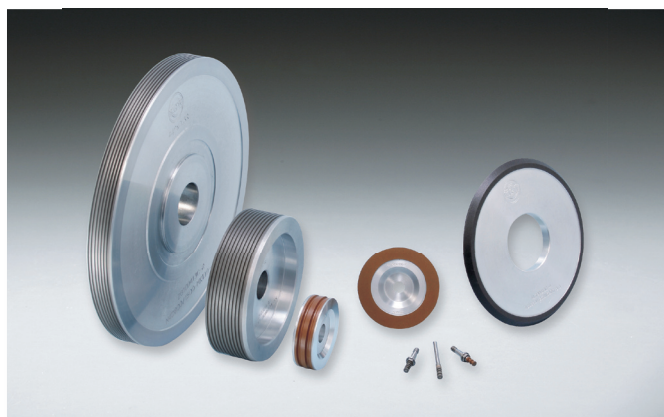
2-6

Back Up

液晶・半導体関連

半導体基板面取り研磨用 ダイヤモンドホイール

レジン | メタル



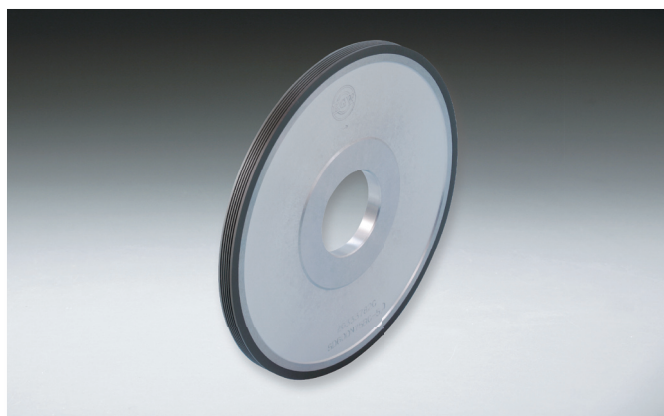
用 途

- ・シリコンウェーハや化合物半導体の面取り研削に使われるダイヤモンドホイールです。
- ・メタルボンドホイールは主に粗研削で使用されます。
- ・レジンボンドホイールは主に仕上げ研削で使用されます。
- ・代表的な面取り機各社の最新鋭機に対応しております。

液晶・半導体関連

サファイアウェーハ面取り研磨用 ダイヤモンドホイール

レジン | メタル



用 途

- ・サファイアウェーハの面取り研削に使われるダイヤモンドホイールです。
- ・高輝度 LED の製造に欠かせないサファイアウェーハは、ダイヤモンドに次ぐモース硬度を持つ難削材ですが、これを高効率・高精度で加工することができます。

2-1

Super
Abrasive

2-2

Bonded
Abrasive

2-3

Dresser

2-4

Coated
Abrasive

2-5

Coolant

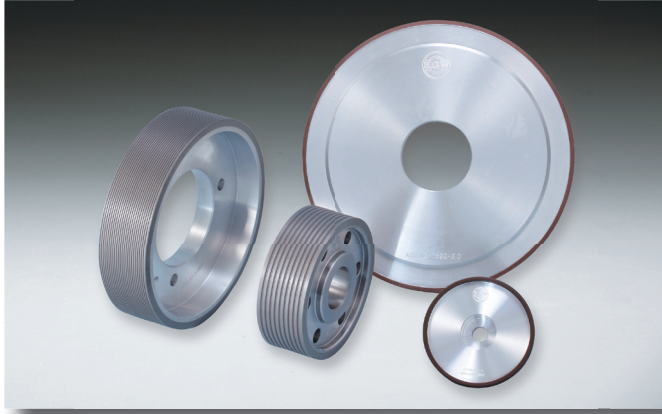
2-6

Back Up

液晶・半導体関連

FPD 面取り研磨用 ダイヤモンドホイール

レジン メタル



用 途

- ・ FPD 市場で、各種硝子基板の面取り研削に使われるダイヤモンドホイールです。
- ・ ホイールの円筒面に溝の入ったメタルボンドホイールは、TFT 硝子基板や PDP(プラズマディスプレイ) 硝子基板などの面取り研削(粗研削)に使われます。
- ・ レジンボンドホイールは、液晶パネルメーカーでパネル電極部の斜め研削に使われたり、また硝子基板メーカーでは面取り研削(精研削)に使われます。

Grinding
Application
Navigator

2-1

Super
Abrasive

2-2

Bonded
Abrasive

2-3

Dresser

2-4

Coated
Abrasive

2-5

Coolant

2-6

Back Up